

PCN No. PCN-SM2111

2021 年 6 月 4 日

富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社

品質保証部

部長 井上 憲一

SOP8パッケージ封止樹脂の変更について（通知）

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

以前、通富微電子 南通工場から合肥工場への後工程移管を PCN（PCN-SM2003）で、南通工場での終息品を PTN（PTN-SM2102）で申請をさせていただいております。その移管前の南通工場の製造品におきまして製造委託先より封止樹脂の一部調達が困難であり、現状の在庫消化後は製造が止まるとの通達がありました。弊社としても既存樹脂の確保を再三にわたり依頼しておりましたが、委託先の回答は変わらず、不本意ながら封止樹脂の変更を余儀なくされる状況になっております。

つきましては、使用樹脂の変更により、製品の製造継続を行って参ります。変更内容は下記の通りとなりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

敬 具

- 記 -

1. 対象品

今回の対象製品は、添付いたしました添付表でご確認をお願いいたします。

また、信頼性評価、スケジュールは、添付表の対象（A）～（D）でのご対応をお願いいたします。

2. 変更内容

変更前： 封止樹脂 A（ハロゲン含有）

変更後： 封止樹脂 B（ハロゲンフリー対応、弊社製品に適用済の材料）

合肥工場移管品は、封止樹脂 B になります。

3. 変更理由

樹脂メーカーにおいて、封止樹脂に使用している一部材料の調達問題が発生しています。

それに伴い、弊社の製品に使用している一部樹脂の調達が困難となったため、使用樹脂を変更します。

ただし、製品外形、リードフレーム、外装めっきに変更はございません。

本変更は、製品供給継続のためであります。何とぞご理解、ご協力をお願いいたします。

4. 変更予定時期

・対象（A）

2021 年 7 月より出荷予定

・対象（B）

2021 年 8 月下旬以降（品質確認後）より出荷予定

・対象（C）

2021 年 9 月中旬以降（品質確認後）より出荷予定

尚、対象（A）対象（B）対象（C）は 10 月から合肥移管品の出荷も開始される予定です。

・対象（D）

2021 年 8 月下旬以降（品質確認後）より出荷予定（2022 年 3 月迄に最終オーダー分を出荷予定）

5．ご依頼

本来であれば事前にご連絡させていただき、評価を含め、ご承認をいただかなければいけないところではありますが、大変急な話であり、作りだめを行う事も出来ない状況にあります。

お客様各位には、大変ご迷惑をお掛けしますが製品の製造継続に向けて本部材変更について、ご了承をいただけますようお願いいたします。

・2021 年 6 月 21 日までに、変更不可の場合は、お手数をお掛けしますが担当営業へご連絡をお願いいたします。

6．添付

PCN_通富微電子 SOP8 封止樹脂変更（合肥・PTN）_説明資料.pptx

対象型格一覧表.xlsx

以上

<連絡先>

富士通セミコンダクターメモリソリューション株式会社

営業統括部 第一営業部

部長 野呂 幸一

Email : noro.kouichi@fujitsu.com